

深圳市卓汇芯科技有限公司是一家集研发、生产、销售和加工服务为一体的技术型企业。现厂房面积 800 多平方米，公司多年专注于芯片加工相关领域，专业生产销售 BGA 植球机、BGA 熔球台、BGA 植锡球治具、BGA 测试治具以及承接芯片拆板翻新、BGA 植球、QFP 整脚、QFN 除锡、芯片自动编带包装等业务，能够高良率、高效率、高产能的为您的企业提供一站式服务！



陈彭华
138 2876 7910

深圳市卓汇芯科技有限公司

电话: 0755-36979941
邮箱: dtflzx@163.com
网址: www.zhxbga.com
地址: 深圳市宝安区西乡街道黄岗岭同和工业区二栋二楼



整套BGA芯片植球设备及耗材、芯片清洗加工再利用方案提供商

设备:
BGA植球机、芯片除锡机、BGA熔球机、芯片摆盘机等

芯片编带:
管装芯片转编带、编带芯片转管装
散装芯片转编带或托盘

芯片加工:
承接 BGA芯片拆卸、清洗、脱锡、植球、装盘 (编带)
QFN芯片拆卸、清洗、脱锡、装盘 (编带)
QFP芯片拆卸、清洗、脱锡、整脚、装盘 (编带)